

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第8回研究会【研究&技術開発パネル展示ディープディスカッション】開催ご案内

主催：(公社)砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
共催：金沢工業大学 FMT 研究所

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第8回研究会では【研究&技術開発パネル展示ディープディスカッション】と題して開催します。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日 時：2017年7月25日(火) 14:00～20:30
第1部 技術講演会 (14:00～18:00)
第2部 パネル展示ディープディスカッション (18:30～20:30)

開催場所：大田区産業プラザ PiO

<http://www.pio-ota.net/access/> (アクセスマップ)

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1丁目20-20

(TEL：03-3733-6600)

京浜急行「京急蒲田」駅より徒歩約3分

JR 京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅より徒歩約13分

※会場を「金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院」から変更
しております。お間違い無きようお願いいたします。



内 容：「テーマ：研究&技術開発パネル展示ディープディスカッション」

第1部

14:00～14:10 開会挨拶

委員長 畷田道雄 (金沢工業大学)

14:10～17:50 話題提供

<技術講演>

1) 14:10～14:45 量産研磨加工技術の開発とその展開

セラテックジャパン株式会社 技術開発チーム チームリーダー 水越健輔 氏

2) 14:45～15:20 CMG ホイールによる Si Wafer 鏡面仕上用固定砥粒新プロセス

株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 技術統括部 研削開発グループ 田代芳章 氏

3) 15:20～15:55 新しい研磨パッドコンディショナーの提案とその特性

昭和工業インターナショナル株式会社 専務取締役 新井雄太郎 氏

～～ 休憩 15:55 ～ 16:15 ～～

4) 16:15～16:50 両面研磨中のウェハ挙動の検討～両面研磨の理論構築を目指して～

金沢大学 理工研究域 機械工学系 助教 橋本洋平 氏

<特別講演>

5) 16:50～17:40 単結晶 SiC の高能率複合研磨技術とレーザー微細複合加工による医療応用技術の開発

国立研究開発法人産業技術総合研究所 製造技術研究部門

表面機能デザイン研究グループ 主任研究員 栗田恒雄 氏

17:40～17:50 技術講演の御礼挨拶

副委員長 會田英雄 (並木精密宝石株式会社)

第2部

18:30～20:30 研究&技術開発パネル展示ディープディスカッション ※詳細は別紙をご覧ください

(研究&技術開発パネル出展団体)

アイオン株式会社, ヴァーデン販売株式会社, 大智化学産業株式会社, 共栄社化学株式会社, 九重電気株式会社,
株式会社奇藤光学製作所, 秀和工業株式会社, 昭和工業インターナショナル株式会社, スリーエムジャパン株式会社, セラテック
ジャパン株式会社, 株式会社タイセイ, 株式会社東京ダイヤモンド工具製作所, 並木精密宝石株式会社, 株式会社ハイテクノス,
パレス化学株式会社, ビクトレックスジャパン株式会社, 不二越機械工業株式会社, 株式会社フジミインコーポレーテッド,
瑞穂企画, 三井金属鉱業株式会社, 八千代マイクロサイエンス株式会社, 金沢大学, 防衛大学校, 神奈川工科大学, 金沢工業大学

☆ショートプレゼンテーションも準備します・軽食とアルコールを含む飲み物も用意します

KENMA 研究会「**第 8 回研究会**」参加申込書

氏 名			
勤務先・所属			
連絡先	住所		
	TEL		FAX
	E-mail		

参加費： 10,000 円

参加申込締切： 平成 29 年 6 月 29 日（木）

申込方法及び問合せ先： 金沢工業大学 工学部 機械工学科 精密工学（畝田）研究室
KENMA 研究会事務局 竹澤瑛里子
TEL：076-248-1100 FAX：076-274-7072
E-mail：unc-asst@neptune.kanazawa-it.ac.jp

必要事項をご記入の上、メールでお申し込みください。

KENMA研究会「第8回研究会」研究&技術開発パネル展示一覧

No.1	大智化学産業株式会社
題目:	遊離砥粒用薬剤の特性とその役割
概要:	遊離砥粒用薬剤の分散技術や特性などをご紹介すると共に各種製品の特徴をご紹介。
担当者:	森 俊史 氏
No.2:	アイオン株式会社
題目:	アイオンクリスタル砥石の特徴と、その使用例
概要:	弊社はPVA等を主原料としたスポンジのメーカーです。PVAスポンジの製法・特徴を生かした、アイオンクリスタル砥石の特徴とその使用例をご紹介します。
担当者:	町田光男 氏
No.3:	セラテックジャパン株式会社
題目:	当社の研磨加工技術
概要:	多種多様な素材に対して平面研磨加工を行うセラテックジャパンの量産化された技術をご紹介します
担当者:	水越健輔 氏
No.4:	八千代マイクロサイエンス株式会社
題目:	分割型ラップ定盤用ダイヤモンド工具「プリエムール」
概要:	光学ガラス、半導体、セラミックス等、脆性材料向けに開発されたダイヤモンド工具がプリエムールです。各素材の特色に合わせてダイヤモンド砥石を選定しており、ユーザー様のご要望に適したタイプをご提案致します。
担当者:	藤森幸広 氏
No.5:	瑞穂企画
題目:	金属の研磨加工
概要:	金属の研磨加工「面粗さ」「平行度」「寸法」のご要望にお応えします
担当者:	松本 剛 氏
No.6:	三井金属鉱業株式会社
題目:	ガラスおよびSiC研摩材の開発
概要:	・酸化セリウム系ガラス用研摩材の新規開発品紹介 ・酸化マンガン系SiC用研摩材の開発品および技術紹介
担当者:	熊谷彰記 氏
No.7:	株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
題目:	CMGホイール並びにデバイス研削用砥石のご紹介
概要:	研磨加工の固定砥粒化を目指してシリコン基板で開発したケモメカニカル反応を利用したCMGホイール（Chemex）をご紹介します。またCMGホイールが適用されるデバイス加工で用いられる研削砥石も併せてご紹介いたします。
担当者:	田代芳章 氏
No.8:	スリーエムジャパン株式会社
題目:	3M(TM) Trizact(TM) 研摩材を用いた研磨技術
概要:	3Mの基幹技術である「高精細表面技術」を研摩材に応用した3M(TM)トライザクト(TM) 研摩材と、その特徴的な構造に起因する研磨性能についてご説明します。
担当者:	則本雅史 氏

No.9:	株式会社ハイテクス
題目:	ボロンドープダイヤモンド砥粒のご紹介
概要:	汎用ダイヤモンド砥粒との違い、特性のご紹介
担当者:	小堀康之 氏
No.10:	株式会社斉藤光学製作所
題目:	0
概要:	0
担当者:	土田益広 氏
No.11:	共栄社化学株式会社
題目:	硬脆材料研磨スラリー用 水溶性ルブリカント エクセムライトPDシリーズ
概要:	サファイアなどに代表される硬脆材料はダイヤモンドスラリーを用いて研磨加工を行う。ダイヤモンド砥粒と混合スラリーとするための水溶性ルブリカントを紹介する。
担当者:	佐藤康任
No.12:	昭和工業インターナショナル株式会社
題目:	新しいパッドコンディショナーのご提案
概要:	これまでのPEEKファイバーを使用したコンディショナーよりも更にドレスカをUPさせた新しいコンディショナーを提案します。
担当者:	新井雄太郎 氏
No.13:	パレス化学株式会社
題目:	最先端ラッピングオイルのご紹介
概要:	弊社は、顧客ニーズに合ったラッピングオイルを開発しております。特に、SiC・サファイア用のラッピングオイルの開発に力を入れており過去に開発した特徴ある性能説明や弊社性能評価方法をご紹介します。
担当者:	高橋 桂 氏
No.14:	並木精密宝石株式会社
題目:	小径基板の洗浄品質の常識を変える洗浄乾燥装置「NAMIKI-ECCLEAR」
概要:	従来10mm以下の小径基板はディップ洗浄とエアブローで乾燥していた。しかし、従来方式ではウォーターマークやパーティクルの付着が問題になることがある。こういった問題を解消する世界初の洗浄乾燥機を紹介する。
担当者:	野瀬 稔 氏
No.15:	ヴァーデン販売株式会社
題目:	ラップ・ポリッシング加工における遊離砥粒分散剤のご紹介
概要:	脆性材料、金属ラップ加工で必要とされる各種分散剤の紹介 ダイヤモンド、GC、酸化セリウム向けなど用途に合わせ幅広く展開しております
担当者:	宮澤信年 氏
No.16:	ビクトレックスジャパン株式会社
題目:	研磨、研削用途へのVICTREX PEEKの提案
概要:	半導体ウエハ製造工程およびウエハー研磨工程へのPEEK + 1の提案
担当者:	吉田直治 氏
No.17:	不二越機械工業株式会社
題目:	不二越機械工業の技術紹介
概要:	研究用片面研磨装置や、研磨Pad表面性状測定器などの製品紹介を通じて、弊社の技術について紹介する。
担当者:	布施貴之 氏

No.18:	株式会社タイセイ
題目:	自社製研磨装置等ご紹介
概要:	ユーザー様のご要望から自社内でのテスト研磨を経て開発された装置のご紹介等、弊社技術のPR
担当者:	梶原富士夫 氏
No.19:	九重電気株式会社
題目:	硬脆材料の精密加工に優れたエポキシ樹脂研磨パッド
概要:	砥粒の保持力の高いエポキシ樹脂研磨パッドの硬化剤に、親水基を有したアミド系硬化剤を用いることで従来のエポキシ樹脂をさらに上回る親水性が得られ、研磨能力が約25%UPした研磨パッドの作製に成功した。
担当者:	野村信幸 氏
No.20:	金沢工業大学
題目:	金沢工業大学 精密工学（畝田）研究室と熱科学（藤本）研究室の紹介
概要:	金沢工業大学 工学部 機械工学科 FMT研究所の精密工学研究室と熱科学研究室で取り組む研究概要を紹介します。
担当者:	藤本雅則 氏
No.21:	株式会社フジインコーポレーテッド
題目:	フジインコーポレーテッドの技術紹介
概要:	弊社の「磨く技術」は半導体をはじめとした様々な産業で活かされています。製品紹介を通じて、研磨事例とともに弊社技術をご紹介いたします。
担当者:	堀田和利 氏
No.22:	秀和工業株式会社
題目:	高脆性化合物半導体基板 鏡面研削
概要:	弊社は研削装置・研磨装置の装置メーカーです。高度な研削・研磨技術で次世代半導体基板の加工技術をリードします。パワー半導体や高輝度LED等で注目されている化合物半導体基板、SiC、GaN等の高脆性材を高度な研削技術で鏡面に仕上げます。また、100um以下の薄仕上げと支持基板からの剥離（割れ・欠けなし）を得意としております。
担当者:	浅石敏彦 氏
No.23:	防衛大学校
題目:	0
概要:	0
担当者:	吉富健一郎 氏
No.24:	金沢大学
題目:	両面研磨中のウエハ挙動の検討～両面研磨の理論構築を目指して～
概要:	両面研磨の技術開発や加工条件検討の多くは、勘と経験に基づき行われている。このような状況の打開を目指し、両面研磨の理論構築に取り組んでおり、その成果としてキャリア内でのウエハ挙動に関する報告を行う。
担当者:	橋本洋平 氏
No.25:	神奈川工科大学
題目:	0
概要:	0
担当者:	今井健一郎 氏